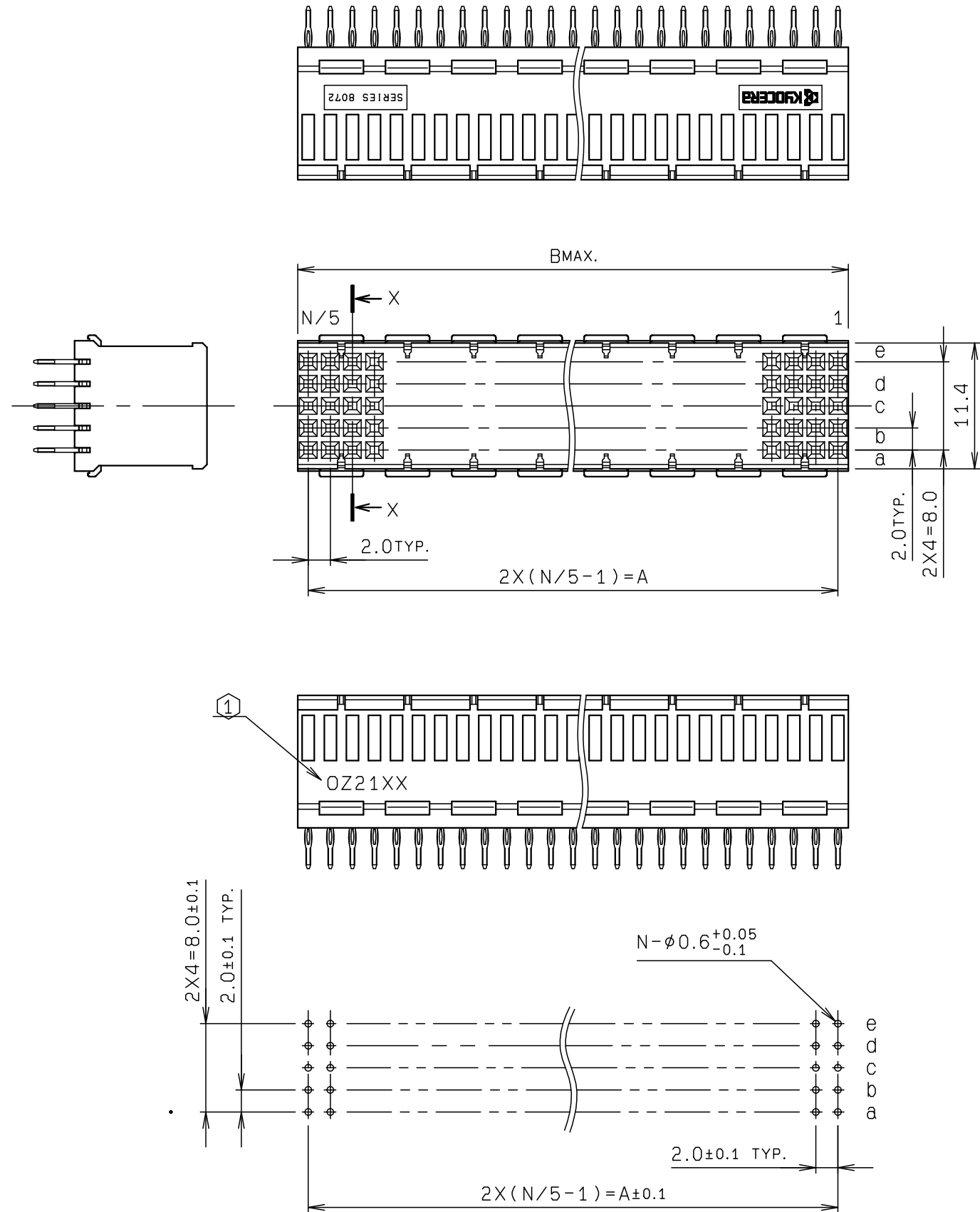
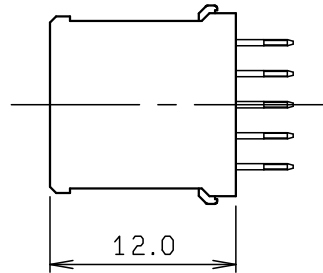


ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

推奨基板取付け寸法（部品面）
RECOMMENDED P. C. BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



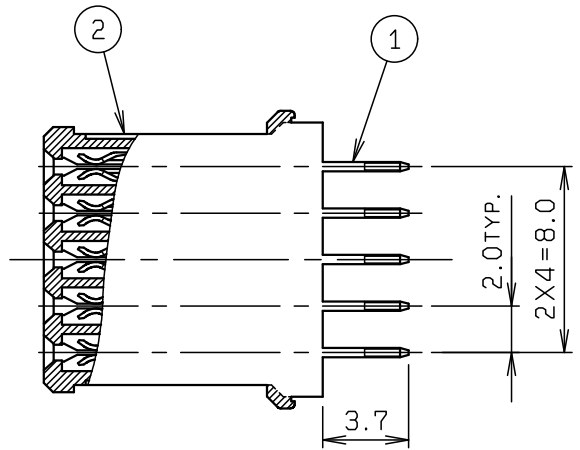
NO. OF POS.	A	B
95	36.0	38.0
110	42.0	44.0
125	48.0	50.0



注記
NOTE

- ① 製造ロット番号表示 LOT. NO.
OZ21XX
製造年 YEAR 製造ラインコード LINE CODE
製造月 MONTH 製造日付 DATE
2. 適用基板仕様 APPLICABLE P. C. BOARD
基板厚 P. C. BOARD THICKNESS:
 $t=1.4 \sim 5.0$ mm
穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA.:
 $\phi 0.7 \pm 0.025$ mm
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS:
 $25 \sim 50 \mu\text{m}$
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA.:
 $\phi 0.6^{+0.05}_{-0.1}$

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONTACT		N	PHOS-BRONZE		
2	REC INSULATOR		1	PBT (GF30%)		UL94V-0 COLOR:GRAY



SECT. X-X (S=3:1)

型番 P/N	27	8072	XXX	000	835	+
接頭 PREFIX	27:リセプタクル/プレスフィット REC PRESS FIT TYPE					
極数 NO. OF POS.	095: 95P 110: 110P 125: 125P					
バリエーション VARIATION	000: ポラライジングキー無し シールド無し WITHOUT POLARIZING KEY WITHOUT SHIELD PLATE					
めっきコード PLATING CODE	835					
下地めっき UNDER COAT	Ni: 1.2 μm MIN.					
接点部めっき CONTACT AREA	Pd/Ni: 0.4 μm MIN. Au 0.03 μm MIN.					
プレスフィット部 PRESS FIT AREA	無光沢Sn: 1.2 μm MIN.					
+: Pb-free						

TOLERANCE / 一般公差 (S)	PRODUCT SPEC / 製品規格	B	DCN21549	2021/07/08	T. OTANI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
X < 10 ± 0.2 $10 \leq X < 30 \pm 0.25$ $30 \leq X \pm 0.3$	UNIT mm	A	DCN19886	2019/08/30	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
ANGLE / 角度 $\pm 3^\circ$	ANGLE 3RD	O	EDN-701	2005/05/26	M. YOSHIDA	Y. SHIROYAMA	N. HAYASHI
SCALE 2:1	DATE 2005/05/26	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
DRAWN T. KOMATSU	DESIGNED M. YOSHIDA	CHECKED Y. SHIROYAMA	APPROVED N. HAYASHI	PART NAME / 品名 SERIES 8072 REC ASSY ST PRESS FIT WITHOUT POLARIZING KEY			
DWG NO. / 図番 BJS 8072023				PART NO. / 型番 27 8072 XXX 000 835 +			
SHEET / REV 1 / 1				B			